

特性

- 》良好的热传导率：**2.6 W/mK**
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性，柔软兼有弹性，适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

应用

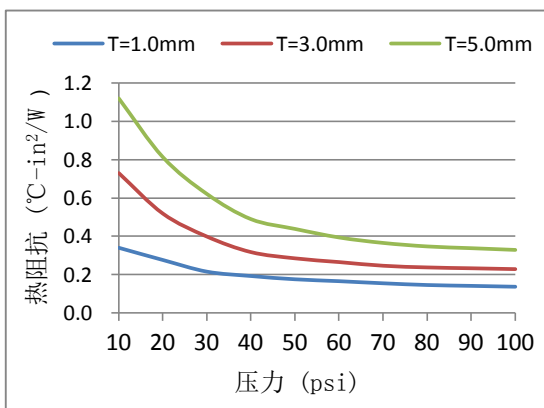
- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电电池
- 》充电桩
- 》LED电视、灯具
- 》显卡模组

TIF™500BS是一种填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

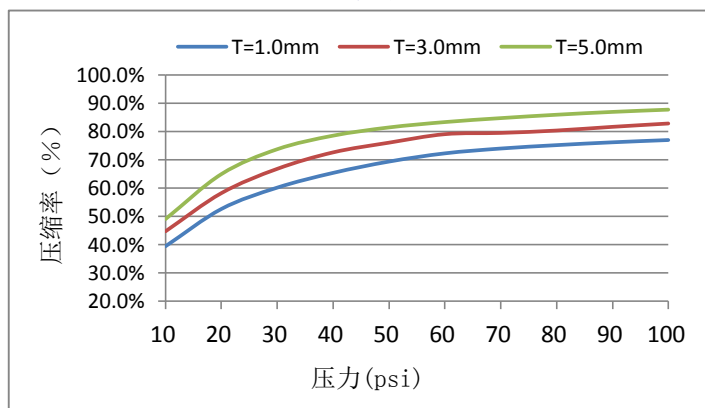
TIF™500BS 系列特性表

颜色	蓝色	Visual
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****
厚度范围	0.020"(0.50mm)~0.200" (5.0mm)	ASTM D374
硬度	13 Shore 00	ASTM 2240
比重	3.0 g/cc	ASTM D297
使用温度范围	-40~160℃	*****
击穿电压(T= 1mm 以上)	>5500 VAC	ASTM D149
介电常数@1MHz	5.0 MHz	ASTM D150
体积电阻率	2.0X10 ¹³ Ohm-cm	ASTM D257
热传导率	2.6 W/mK	ASTM D5470
	2.6 W/mK	GB-T32064
总质量损失 (TML)	0.45%	ASTM E595
防火等级	94 -V0	UL E331100

热阻抗



压缩率



产品型号说明 : TIF5 00 - BS - A1

产品类别 ← TIF5 00 → 厚度:10-200mils
 A1: 单面背胶 A2: 双面背胶
 BS: 产品型号

导热介面材料
应用技术下载



<http://www.ziitek.com>

产品规格

标准厚度:0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm) 标准尺寸:8"×16" (203mm×406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。欲了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

导热材料

导热工程塑料

发热材料

屏蔽材料

发泡硅胶

模切制品

加拿大:

Tel:+001-604-2998559
E-mail: frances@thermazig.com

中国:

Tel: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw

台湾:

Tel:+886-2-22771007
E-mail:frances@ziitek.com.tw